

中国DSP芯片（数字信号处理器）行业“十四五”市场前景与发展规划 分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：DSP芯片行业界定及数据统计标准说明

1.1 DSP芯片的界定与分类

1.1.1 DSP芯片的界定

1.1.2 DSP芯片的分类

1.2 DSP芯片相关概念的界定与区分

1.2.1 DSP芯片与FPGA 芯片

1.2.2 DSP芯片与MPU芯片

1.2.3 DSP芯片与MCU芯片

1.3 DSP芯片行业专业术语介绍

1.4 DSP芯片行业归属国民经济行业分类

1.5 本报告研究范围界定说明

1.6 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：中国DSP芯片行业“十四五”PEST（宏观环境）分析

2.1 中国DSP芯片行业“十四五”政治（Politics）环境

2.1.1 DSP芯片行业监管体系及机构介绍

(1) DSP芯片行业主管部门

(2) DSP芯片行业自律组织

2.1.2 DSP芯片行业标准体系建设现状

(1) DSP芯片标准体系建设

(2) DSP芯片现行标准汇总

(3) DSP芯片即将实施标准

(4) DSP芯片重点标准解读

2.1.3 DSP芯片行业发展相关政策规划汇总及解读

(1) DSP芯片行业发展相关政策汇总

(2) DSP芯片行业发展相关规划汇总

2.1.4 “十四五”规划对DSP芯片行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对DSP芯片行业的影响分析

2.1.6 政策环境对DSP芯片行业发展的影响分析

2.2 中国DSP芯片行业“十四五”经济（Economy）环境

2.2.1 宏观经济发展现状

2.2.2 宏观经济发展展望

2.2.3 DSP芯片行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国DSP芯片行业“十四五”社会（Society）环境

2.4 中国DSP芯片行业“十四五”技术（Technology）环境

2.4.1 DSP芯片生产制造工艺

2.4.2 DSP芯片行业核心关键技术分析

2.4.3 DSP芯片行业的研发创新现状

2.4.4 DSP芯片行业相关专利的申请及公开情况

(1) DSP芯片专利申请

(2) DSP芯片专利公开

(3) DSP芯片热门申请人

(4) DSP芯片热门技术

2.4.5 技术环境对DSP芯片行业发展的影响分析

第3章：全球DSP芯片行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球DSP芯片行业发展历程

3.2 全球DSP芯片行业政策环境

3.3 全球DSP芯片行业技术环境

3.4 全球DSP芯片行业发展现状

3.4.1 全球DSP芯片行业产业化发展现状

- 3.4.2 德国DSP芯片行业发展状况
- 3.4.3 美国DSP芯片行业发展状况
- 3.5 全球DSP芯片行业市场规模测算
- 3.6 全球DSP芯片行业市场竞争格局及兼并重组状况
 - 3.6.1 全球DSP芯片行业市场竞争格局
 - 3.6.2 全球DSP芯片企业兼并重组状况
- 3.7 全球DSP芯片行业代表性企业发展布局案例
 - 3.7.1 全球DSP芯片行业代表性企业布局对比
 - 3.7.2 全球DSP芯片行业代表性企业布局案例
 - (1) 德州仪器（TI）
 - (2) 模拟器件公司（ADI）
 - (3) 摩托罗拉（Motorola）公司
- 3.8 全球DSP芯片行业发展趋势及市场前景预测
 - 3.8.1 全球DSP芯片行业发展趋势预判
 - 3.8.2 全球DSP芯片行业市场前景预测
- 第4章：中国DSP芯片上游布局现状及“十四五”前瞻**
 - 4.1 中国DSP芯片产业结构属性（产业链）
 - 4.1.1 DSP芯片产业链结构梳理
 - 4.1.2 DSP芯片产业链生态图谱
 - 4.2 中国DSP芯片产业价值属性（价值链）
 - 4.2.1 DSP芯片行业成本结构分析
 - 4.2.2 DSP芯片行业价值链分析
 - 4.3 中国DSP芯片上游芯片设计市场分析
 - 4.4 中国DSP芯片上游半导体材料市场分析
 - 4.5 中国DSP芯片上游半导体设备市场分析
 - 4.6 中国DSP芯片产业上游“十四五”布局前瞻
- 第5章：中国DSP芯片产业中游市场供给及“十四五”前瞻**
 - 5.1 中国DSP芯片行业发展历程介绍
 - 5.2 中国DSP芯片行业市场特性分析
 - 5.3 中国DSP芯片行业参与者类型及入场方式
 - 5.4 中国DSP芯片行业参与者企业数量规模
 - 5.5 中国DSP芯片行业市场供给状况
 - 5.6 中国DSP芯片市场行情及走势
 - 5.7 中国芯片行业封装测试市场发展
 - 5.8 中国DSP芯片产业“十四五”市场供给前瞻
 - 5.8.1 中国DSP芯片产业“十四五”市场供给趋势
 - 5.8.2 中国DSP芯片产业“十四五”市场供给预测
- 第6章：中国DSP芯片进出口市场现状及“十四五”前瞻**
 - 6.1 国内外DSP芯片产业技术及产品对比与差距/差异分析
 - 6.2 中国DSP芯片行业进出口整体状况
 - 6.3 中国DSP芯片行业进口状况
 - 6.3.1 中国DSP芯片行业进口规模
 - 6.3.2 中国DSP芯片行业进口价格水平
 - 6.3.3 中国DSP芯片行业进口产品结构
 - 6.3.4 中国DSP芯片行业主要进口来源地
 - 6.3.5 中国DSP芯片进口影响因素及趋势预判
 - 6.4 中国DSP芯片行业出口状况
 - 6.4.1 中国DSP芯片行业出口规模
 - 6.4.2 中国DSP芯片行业出口价格水平
 - 6.4.3 中国DSP芯片行业出口产品结构
 - 6.4.4 中国DSP芯片行业主要出口目的地
 - 6.4.5 中国DSP芯片出口影响因素及趋势预判
 - 6.5 中国DSP芯片产业“十四五”进出口市场前景
 - 6.5.1 中国DSP芯片产业“十四五”进出口发展趋势预判
 - 6.5.2 中国DSP芯片产业“十四五”进出口市场前景预测
- 第7章：中国DSP芯片市场需求现状及“十四五”前瞻**
 - 7.1 中国DSP芯片行业市场需求分析
 - 7.1.1 中国DSP芯片行业销量规模
 - 7.1.2 中国DSP芯片行业招投标情况

- 7.2 中国DSP芯片行业供需平衡状态及缺口规模测算
- 7.3 中国DSP芯片行业市场规模测算
- 7.4 中国DSP芯片行业市场需求特征分析
- 7.5 中国DSP芯片产业“十四五”市场需求前瞻
 - 7.5.1 中国DSP芯片产业“十四五”市场需求趋势预判
 - 7.5.2 中国DSP芯片产业“十四五”市场需求前景预测
- 第8章：中国DSP芯片产业下游应用场景“十四五”需求潜力分析
 - 8.1 中国DSP芯片下游应用场景结构介绍
 - 8.2 中国DSP芯片下游应用场景需求潜力分析
 - 8.2.1 通信领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.2.2 消费电子领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.2.3 汽车安全及自动控制领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.2.4 军事/航空领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.2.5 仪器仪表领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.2.6 工业控制领域DSP芯片市场需求分析
 - 8.3 中国DSP芯片产业下游应用“十四五”发展趋势
- 第9章：中国DSP芯片行业竞争状况及“十四五”前瞻
 - 9.1 中国DSP芯片行业波特五力模型分析
 - 9.1.1 DSP芯片行业现有竞争者之间的竞争
 - 9.1.2 DSP芯片行业关键要素的供应商议价能力分析
 - 9.1.3 DSP芯片行业消费者议价能力分析
 - 9.1.4 DSP芯片行业潜在进入者分析
 - 9.1.5 DSP芯片行业替代品风险分析
 - 9.1.6 DSP芯片行业竞争情况总结
 - 9.2 中国DSP芯片行业投融资、兼并与重组状况
 - 9.2.1 中国DSP芯片行业投融资发展状况
 - (1) DSP芯片行业资金来源
 - (2) DSP芯片投融资主体
 - (3) DSP芯片投融资方式
 - (4) DSP芯片投融资事件汇总
 - (5) DSP芯片投融资信息汇总
 - (6) DSP芯片投融资趋势预测
 - 9.2.2 中国DSP芯片行业兼并与重组状况
 - (1) DSP芯片兼并与重组事件汇总
 - (2) DSP芯片兼并与重组动因分析
 - (3) DSP芯片兼并与重组案例分析
 - (4) DSP芯片兼并与重组趋势预判
 - 9.3 中国DSP芯片行业市场竞争格局分析
 - 9.4 中国DSP芯片行业市场集中度分析
 - 9.5 中国DSP芯片行业海外布局状况
 - 9.6 中国DSP芯片行业国际竞争力分析
 - 9.7 中国DSP芯片产业“十四五”市场竞争趋势预判
- 第10章：中国DSP芯片市场痛点及“十四五”国产化发展布局
 - 10.1 中国DSP芯片行业经营效益分析
 - 10.2 中国DSP芯片行业商业模式分析
 - 10.3 中国DSP芯片行业市场痛点分析
 - 10.4 中国DSP芯片产业国产化“十四五”发展路径及布局动态
- 第11章：中国DSP芯片代表性企业国产化布局案例研究
 - 11.1 中国DSP芯片代表性企业国产化布局对比
 - 11.2 中国DSP芯片代表性企业国产化布局案例（排名不分先后）
 - 11.2.1 国睿科技股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
 - 11.2.2 龙芯中科技术股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况

- (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.3 四创电子股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.4 中颖电子股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.5 深圳市海思半导体有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.6 江苏宏云技术有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.7 北京中科昊芯科技有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.8 深圳市创成微电子有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.9 湖南进芯电子科技有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析
- 11.2.10 北京赛微电子股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业DSP芯片国产化布局状况
 - (4) 企业DSP芯片业务布局优劣势分析

第12章：中国DSP芯片行业“十四五”投资机会分析

12.1 中国DSP芯片行业“十四五”投资风险预警及防范

- 12.1.1 DSP芯片行业政策风险及防范
- 12.1.2 DSP芯片行业技术风险及防范
- 12.1.3 DSP芯片行业宏观经济波动风险及防范
- 12.1.4 DSP芯片行业关联产业风险及防范
- 12.1.5 DSP芯片行业其他风险及防范

12.2 中国DSP芯片行业“十四五”市场进入壁垒分析

- 12.2.1 DSP芯片行业人才壁垒
- 12.2.2 DSP芯片行业技术壁垒
- 12.2.3 DSP芯片行业资金壁垒
- 12.2.4 DSP芯片行业其他壁垒

12.3 中国DSP芯片行业“十四五”投资价值评估

12.4 中国DSP芯片行业“十四五”投资机会分析

- 12.4.1 DSP芯片行业产业链薄弱环节投资机会
- 12.4.2 DSP芯片行业细分领域投资机会
- 12.4.3 DSP芯片行业区域市场投资机会
- 12.4.4 DSP芯片产业空白点投资机会

第13章：中国DSP芯片行业“十四五”发展策略建议

13.1 中国DSP芯片行业“十四五”发展策略

13.2 中国DSP芯片行业“十四五”可持续发展建议

图表目录

- 图表1：国家统计局对DSP芯片行业的定义与归类
- 图表2：本报告研究范围界定
- 图表3：本报告的主要数据来源及统计标准说明
- 图表4：DSP芯片行业主管部门
- 图表5：DSP芯片行业自律组织
- 图表6：截至2021年DSP芯片行业标准汇总
- 图表7：截至2021年DSP芯片行业发展政策汇总
- 图表8：截至2021年DSP芯片行业发展规划汇总
- 图表9：全球DSP芯片行业发展趋势预判
- 图表10：2021-2026年DSP芯片行业市场前景预测
- 图表11：DSP芯片产业链结构
- 图表12：DSP芯片产业链生态图谱
- 图表13：DSP芯片行业生产企业
- 图表14：DSP芯片行业现有企业的竞争分析表
- 图表15：DSP芯片行业对上游议价能力分析表
- 图表16：DSP芯片行业对下游议价能力分析表
- 图表17：DSP芯片行业潜在进入者威胁分析表
- 图表18：中国DSP芯片行业五力竞争综合分析
- 图表19：中国DSP芯片行业市场发展痛点分析
- 图表20：中国DSP芯片产业链代表性企业发展布局对比
- 图表21：国睿科技股份有限公司发展历程
- 图表22：国睿科技股份有限公司基本信息表
- 图表23：国睿科技股份有限公司股权穿透图
- 图表24：国睿科技股份有限公司经营状况
- 图表25：国睿科技股份有限公司整体业务架构
- 图表26：国睿科技股份有限公司销售网络布局
- 图表27：国睿科技股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表28：龙芯中科技术股份有限公司发展历程
- 图表29：龙芯中科技术股份有限公司基本信息表
- 图表30：龙芯中科技术股份有限公司股权穿透图
- 图表31：龙芯中科技术股份有限公司经营状况
- 图表32：龙芯中科技术股份有限公司整体业务架构
- 图表33：龙芯中科技术股份有限公司销售网络布局
- 图表34：龙芯中科技术股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表35：四创电子股份有限公司发展历程
- 图表36：四创电子股份有限公司基本信息表
- 图表37：四创电子股份有限公司股权穿透图
- 图表38：四创电子股份有限公司经营状况
- 图表39：四创电子股份有限公司整体业务架构
- 图表40：四创电子股份有限公司销售网络布局
- 图表41：四创电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表42：中颖电子股份有限公司发展历程
- 图表43：中颖电子股份有限公司基本信息表
- 图表44：中颖电子股份有限公司股权穿透图
- 图表45：中颖电子股份有限公司经营状况
- 图表46：中颖电子股份有限公司整体业务架构
- 图表47：中颖电子股份有限公司销售网络布局
- 图表48：中颖电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
- 图表49：深圳市海思半导体有限公司发展历程
- 图表50：深圳市海思半导体有限公司基本信息表

图表51: 深圳市海思半导体有限公司股权穿透图
图表52: 深圳市海思半导体有限公司经营状况
图表53: 深圳市海思半导体有限公司整体业务架构
图表54: 深圳市海思半导体有限公司销售网络布局
图表55: 深圳市海思半导体有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表56: 江苏宏云技术有限公司发展历程
图表57: 江苏宏云技术有限公司基本信息表
图表58: 江苏宏云技术有限公司股权穿透图
图表59: 江苏宏云技术有限公司经营状况
图表60: 江苏宏云技术有限公司整体业务架构
图表61: 江苏宏云技术有限公司销售网络布局
图表62: 江苏宏云技术有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表63: 北京中科昊芯科技有限公司发展历程
图表64: 北京中科昊芯科技有限公司基本信息表
图表65: 北京中科昊芯科技有限公司股权穿透图
图表66: 北京中科昊芯科技有限公司经营状况
图表67: 北京中科昊芯科技有限公司整体业务架构
图表68: 北京中科昊芯科技有限公司销售网络布局
图表69: 北京中科昊芯科技有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表70: 深圳市创成微电子有限公司发展历程
图表71: 深圳市创成微电子有限公司基本信息表
图表72: 深圳市创成微电子有限公司股权穿透图
图表73: 深圳市创成微电子有限公司经营状况
图表74: 深圳市创成微电子有限公司整体业务架构
图表75: 深圳市创成微电子有限公司销售网络布局
图表76: 深圳市创成微电子有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表77: 湖南进芯电子科技有限公司发展历程
图表78: 湖南进芯电子科技有限公司基本信息表
图表79: 湖南进芯电子科技有限公司股权穿透图
图表80: 湖南进芯电子科技有限公司经营状况
图表81: 湖南进芯电子科技有限公司整体业务架构
图表82: 湖南进芯电子科技有限公司销售网络布局
图表83: 湖南进芯电子科技有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表84: 北京赛微电子股份有限公司发展历程
图表85: 北京赛微电子股份有限公司基本信息表
图表86: 北京赛微电子股份有限公司股权穿透图
图表87: 北京赛微电子股份有限公司经营状况
图表88: 北京赛微电子股份有限公司整体业务架构
图表89: 北京赛微电子股份有限公司销售网络布局
图表90: 北京赛微电子股份有限公司DSP芯片业务布局优劣势分析
图表91: 中国DSP芯片行业市场进入与退出壁垒分析
图表92: 中国DSP芯片行业市场投资价值评估
图表93: 中国DSP芯片行业投资机会分析
图表94: 中国DSP芯片行业投资策略与建议
图表95: 中国DSP芯片行业可持续发展建议
如需完整目录请联系客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！